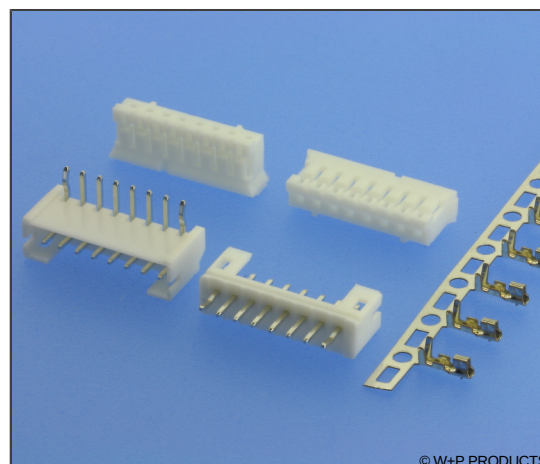


Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt

Friction Lock Headers / Crimp Housings, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

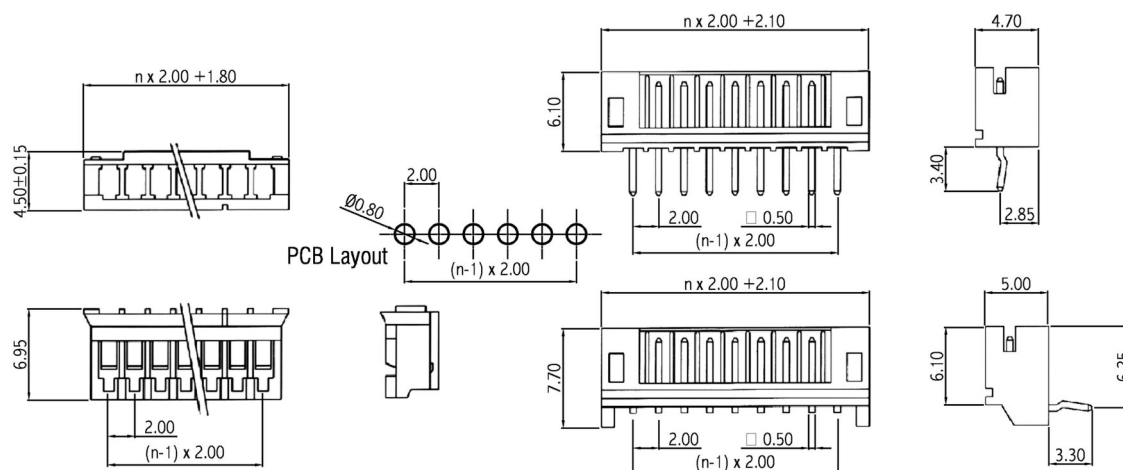
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0.50mm, copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 30 ~ 24
Applicable wire Gauge	AWG 30 ~ 24
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	800 V AC
Test Voltage	800 V AC
Nennspannung	100 V AC
Voltage Rating	100 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Temperature Range	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS

Buchsengehäuse passt auch zur Serie:
Housing mates also with Series:

5210

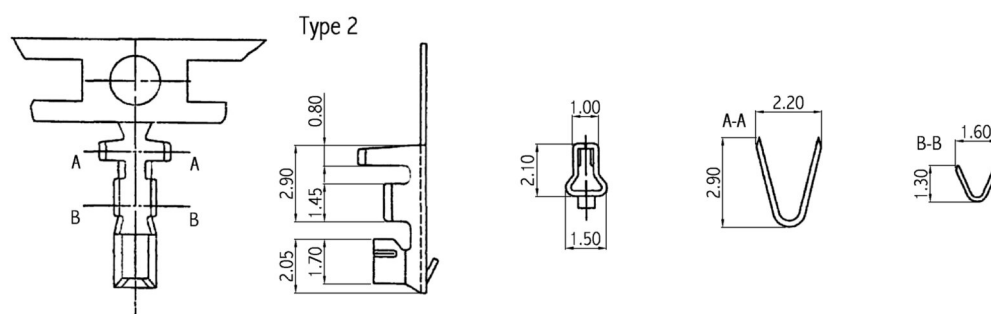


Series	Contacts*	Type*	Plating
521	12	3	50

02-16

1 Buchsengehäuse
Housing
3 Stiftleiste gerade
Straight pin header
4 Stiftleiste gewinkelt
Right-angled pin header

50 Verzinnt (für Gehäuse nicht erforderlich)
Tin plated (not used for housings)
XX (ohne Plating für Gehäuse)
(without plating, for housings)



Series	Contacts	Type	Plating
521	01	2	50

2 Buchsenkontakte AWG 24-30
Crimp Terminals AWG 24-30

50 Verzinnt
Tin plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

